

多芯片组



[多芯片组_下载链接1](#)

著者:杨邦朝 张经国

出版者:电子科技大学出版社

出版时间:2001-08-01

装帧:

isbn:9787810655811

多芯片组件（MCM）是一种先进的微电子组装与封装技术，是目前能最大限度发挥高集成度、高速半导体IC性能，制作高速电子系统，实现电子整机小型化和系统集成的有效途径。

本书从理论和技术两个方面全面、系统地论述了多芯片组件技术的基本概念、特点，发展MCM技术必须解决的关键技术，以及国内外多芯片技术发展现状。全书分三篇共20章，内容包括多芯片组件的电设计和热设计技术、高密度多层布线基板技术、LSI芯

作者介绍:

目录: 第一篇 总论
第一章 电子组装技术概述
1.1 电子组装技术的变迁
1.2 电子组装工程学
1.2.1 什么是电子组装工程学
1.2.2 电子组装工程或技术的范围与体系
• • • • • [\(收起\)](#)

[多芯片组_下载链接1_](#)

标签

评论

[多芯片组_下载链接1_](#)

书评

[多芯片组_下载链接1_](#)